МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
(МИИГАиК)

Факультет оптического приборостроения
Кафедра технологии оптического приборостроения

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5387FD2AF5B17FED816FDE9A1D4973B1
Владелец: Степанченко Алексей Леонидович
Действителен: с 21.07.2025 по 14.10.2026

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор
А. Л. Степанченко
18 апреля 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ «Б1.В.08.03 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 12.03.02 Оптотехника

Направленность(профиль) подготовки: Оптико-электронные приборы и системы

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2025

Срок получения образования: 4 года

Объем: в зачетных единицах: 5 з.е.
в академических часах: 180 ак.ч.

Москва, 2025

Разработчики:
Старший преподаватель кафедры Технологии оптического приборостроения Соколова Е. Н.

Рецензенты:
Голыгин Н.Х., доцент, доцент кафедры ТОП

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.02 Оптотехника, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.02.0017 № 948

Согласование и утверждение

№	Подразделение	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	факультет Оптического приборостроения	Председатель ученого совета факультета	Торшина И. П.	Рассмотрено	15.01.2025, № 2/24-25

1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ПК-4 Способность к разработке технологических процессов и технической документации на изготовление, сборку, юстировку и контроль механических, оптических, оптико-электронных блоков, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.

ПК-4.1 Разрабатывает технологические процессы изготовления оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

Знать:

ПК-4.1/Зн1 Оптические материа-лы и технологии. Технологические возможности обору-дования для произ-водства оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей. Компонентная и эле-ментная базы оптиче-ских и оптико-электронных прибо-ров и комплексов. Характеристики кон-трольно-измерительного обо-рудования для сбор-ки, юстировки и кон-троля оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей. Оценивать уровень технического и тех-нологического по-тенциала организа-ции (организаций-контрагентов), необ-ходимый для изго-товления оснастки и специального ин-струмента.

ПК-4.1/Зн2 Принципы построения технологических процессов с учетов технических требований к изделию. Основы теории современных материалов

Уметь:

ПК-4.1/Ум1 Применять существующие технологии и режимы производства, сборки, юстировки и контроля разрабатываемых оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-4.1/Ум2 Использовать справочную литературу для выбора материалов и их внедрения в существующие технологические процессы производства пакеты прикладных программ для проектирования и конструирования оптических и оптико-электронных приборов и комплексов и системы электронного документооборота

Владеть:

ПК-4.1/Нв1 Продемонстрировал логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания (проекта, портфолио), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса)

ПК-4.1/Нв2 Навыками разработки и корректировки технологических процессов изготовления и сборки элементов приборов

ПК-4.2 Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и контроля современных оптических и оптико-электронных приборов и комплексов

Знать:

ПК-4.2/Зн6 Оптические материалы и технологии.

ПК-4.2/Зн8 Методы системного анализа.

ПК-4.2/Зн10 Компьютерные технологии и программные средства проектирования и конструирования.

Уметь:

ПК-4.2/Ум1 Определять технологические требования к изготовлению оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-4.2/Ум3 Определять и обосновывать требования к изготовлению оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей с учетом требований технического задания и возможностей организации изготовителя.

ПК-4.2/Ум4 Проектировать технологические процессы изготовления деталей, сборки, юстировки и контроля оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов.

Владеть:

ПК-4.2/Нв2 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

ПК-4.2/Нв3 Навыками разработки и корректировки технологических процессов изготовления и сборки элементов приборов

ПК-4.3 Разрабатывает и вносит предложения по корректировке конструкторской и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия

Знать:

ПК-4.3/Зн1 Методы системного анализа. Технологические возможности оборудования для производства оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-4.3/Зн2 Принципы построения технологических процессов с учетов технических требований к изделию. Основы теории современных материалов

ПК-4.3/Зн3 Обоснования предлагаемые решения. Обоснованиятребования к изготовлению оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей с учетом требований технического задания и возможностей организации-изготовителя.

Уметь:

ПК-4.3/Ум1 Обосновывать требования к изготовлению оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей с учетом требований технического задания и возможностей организации-изготовителя

ПК-4.3/Ум2 Использовать справочную литературу для выбора материалов и их внедрения в существующие технологические процессы производства пакеты прикладных программ для проектирования и конструирования оптических и оптико-электронных приборов и комплексов и системы электронного документооборота

ПК-4.3/Ум3 Разрабатывать конструкторскую документацию. Определять технологические требования к изготовлению оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей. Обосновывать требования к изготовлению оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей с учетом требований технического задания и возможностей организации-изготовителя. Разрабатывать и согласовывать извещения об изменении конструкторской документации.

Владеть:

ПК-4.3/Нв1 Самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса)

ПК-4.3/Нв3 Методами оптических измерений геометрических параметров оптических элементов, параметров оптических материалов, характеристик оптических систем, параметров световой волны, методов испытания оптических систем, исследования качества оптического изображения

2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые результаты освоения программы	Уровень овладения	Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ по уровням освоения)

3. Шкала оценивания

Оценка	Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)
Неудовле-творительно	Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне
Оценка	Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)
Не зачтено	Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	
Промежуточная аттестация	Контрольная работа Зачет Курсовая работа Экзамен

№ п/п	Наименование раздела	Контролируемые ИДК	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
			Текущий	Промежут. аттестация
1	Введение. Задачи и содержание курса, его связь с другими дисциплинами.	ПК-4.1		Зачет Курсовая работа Экзамен
2	Введение. Задачи и содержание курса, его связь с другими дисциплинами.	ПК-4.1		Зачет Курсовая работа Экзамен
3	Производство заготовок в оптическом приборостроении.	ПК-4.1		Зачет Курсовая работа Экзамен
4	Обработка на металлорежущих станках.	ПК-4.1		Зачет Курсовая работа Экзамен
5	Обработка на отделочных станках.	ПК-4.1		Зачет Курсовая работа Экзамен
6	Электрофизические, электрохимические и лучевые методы размерной обработки.	ПК-4.2		Зачет Курсовая работа Экзамен
7	Основы проектирования технологических процессов.	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3		Зачет Курсовая работа Экзамен

8	Припуски под механическую обработку.	ПК-4.2		Зачет Курсовая работа Экзамен
9	Базы и базирование.	ПК-4.2		Зачет Курсовая работа Экзамен
10	Понятие о точности и качестве обработки деталей.	ПК-4.3		Зачет Курсовая работа Экзамен
11	Методы оценки точности технологических процессов.	ПК-4.3		Зачет Курсовая работа Экзамен
12	Основы технического нормирования.	ПК-4.3		Зачет Курсовая работа Экзамен
13	Технологическая оснастка.	ПК-4.3		Зачет Курсовая работа Экзамен
14	Основы проектирования приспособлений.	ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3		Зачет Курсовая работа Экзамен
15	Технологические процессы изготовления типовых деталей.	ПК-4.2		Зачет Курсовая работа Экзамен
16	Технологические процессы изготовления специальных деталей.	ПК-4.3		Зачет Курсовая работа Экзамен
17	Покрытия в приборостроении.	ПК-4.2		Зачет Курсовая работа Экзамен

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальными нормативными актами Университета:
- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
- Положением о порядке осуществления образовательного процесса, проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии», п.8 «Проведение промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Зачет, 5 семестр.

Промежуточная аттестация: Курсовая работа, 6 семестр.

Промежуточная аттестация: Экзамен, 6 семестр.

6. Оценочные материалы текущего контроля

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5 семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
Вопросы/Задания:

1. Какая погрешность обработки деталей может появиться при нарушении правила совмещения баз, т.е. выбранная при разработке техпроцесса технологическая база не будет совпадать с конструкторской базой?

2. Отработка конструкции изделия на технологичность на этапе подготовки производства позволяет?
1. уменьшить себестоимость его изготовления
2. увеличить его материалоемкость
3. увеличить его массу и габаритные размеры
4. увеличить время его обработки

3. При выборе оптимального варианта технологического процесса изготовления изделия оптико-электронного прибора по производительности процесса учитывают:
1. денежные затраты
2. энергозатраты
3. затраты времени
4. затраты материалов

4. При выборе оптимального варианта технологического процесса изготовления изделия оптико-электронного прибора по производительности процесса учитывают….?
1. Денежные затраты
2. Энергозатраты

3. Затраты времени
4. Затраты материалов

5. Что может появиться в местах утолщения конструкции отливки, получаемой литьем под давлением, при нарушении ее равнотолщинности?

6 семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Вопросы/Задания:

1. 1. Какие типы производства различают в приборостроении и их характеристика.
2. Виды технологических процессов
3. Основные цели и задачи технологической подготовки производства.
4. Виды оценки технологичности конструкции изделий.
5. Основные этапы разработки техпроцесса.
6. Типизация технологических процессов.
7. Групповой техпроцесс.
8. Методы определения припуска на механическую обработку.
9. Базы и правила базирования
10. Методы обеспечения точности обработки деталей.
11. Производственные погрешности, возникающие при механической обработке.
12. Методы оценки точности техпроцессов.
13. Факторы, влияющие на качество обрабатываемой поверхности.
14. Что называется нормой времени?
15. Выбор оптимального варианта техпроцесса изготовления детали.
16. Какие способы получения заготовок позволяют снизить объем обработки резанием?
17. Основные методы обработки заготовок в приборостроении.

6 семестр, Курсовая работа

Контролируемые ИДК: ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Вопросы/Задания:

1. 1. Какие типы производства различают в приборостроении и их характеристика.
2. Виды технологических процессов
3. Основные цели и задачи технологической подготовки производства.
4. Виды оценки технологичности конструкции изделий.
5. Основные этапы разработки техпроцесса.
6. Типизация технологических процессов.
7. Групповой техпроцесс.
8. Методы определения припуска на механическую обработку.
9. Базы и правила базирования
10. Методы обеспечения точности обработки деталей.
11. Производственные погрешности, возникающие при механической обработке.
12. Методы оценки точности техпроцессов.
13. Факторы, влияющие на качество обрабатываемой поверхности.
14. Что называется нормой времени?
15. Выбор оптимального варианта техпроцесса изготовления детали.
16. Какие способы получения заготовок позволяют снизить объем обработки резанием?
17. Основные методы обработки заготовок в приборостроении.